

# 工業技術研究院

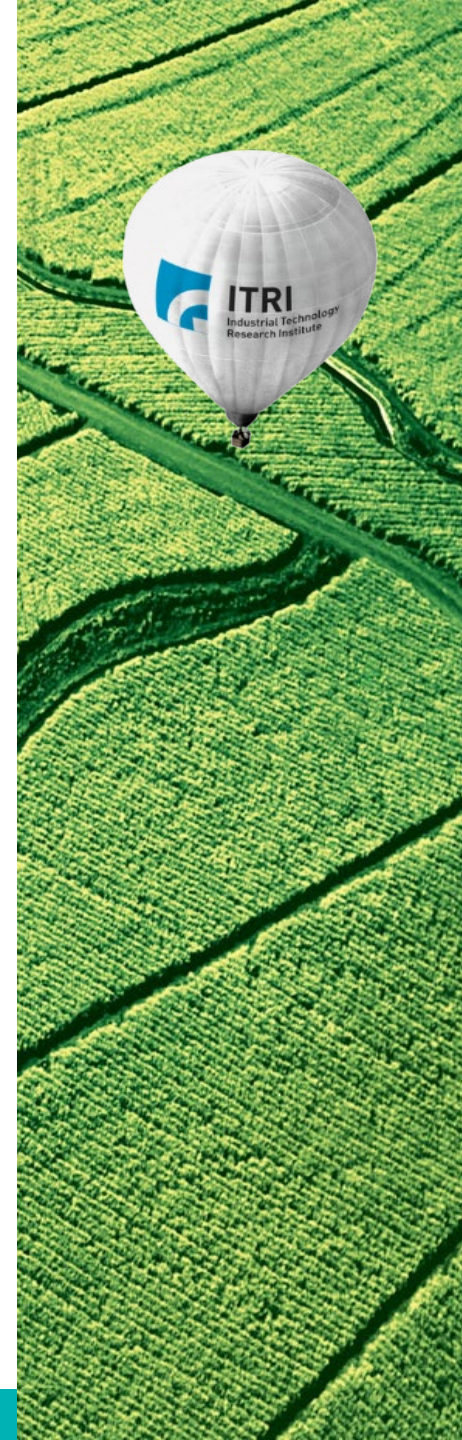
Industrial Technology  
Research Institute

## 印尼、馬來西亞、泰國 電子產業地圖解析

吳佩玲 博士/副組長

工研院產業科技國際策略發展所 亞太產業研究組

2026/06/09



# 簡報大綱

1. 泰國電子投資環境及產業地圖解析
2. 馬來西亞投資環境及產業地圖解析
3. 印尼投資環境及產業地圖解析
4. IEKView

# 簡報大綱

1. 泰國電子投資環境及產業地圖解析
2. 馬來西亞投資環境及產業地圖解析
3. 印尼投資環境及產業地圖解析
4. IEKView

# 泰國產業發展概述



## 總體經濟

- 2025年泰國**出口額**達3,448億美元，創下歷史新高，進口額則為3,397億美元，使全年貿易順差達51億美元。主要原因包括**全球電子與科技產品需求回溫**，帶動泰國電子零組件、電腦設備及相關電機產品出口成長。近2年對資本設備與關鍵零組件（如IC）的備料需求大增，反映**製造業擴張期**的特徵。
- 經濟成長率中長期看起來仍是3%左右的穩健成長軌道。足見泰國不是靠「高成長率」吸引投資，而是靠**產業基礎與供應鏈位置**。

## 產業成長動能

- 泰國為東協重要電子製造基地，聚集多家國際半導體與PCB廠商，受惠於政府投資優惠與外資湧入，電子零組件與智慧製造產值持續攀升，帶動**高階晶片與AI應用**產業成長。

## 主要電子產業聚落

- 泰國主要電子產業聚落位於中部之**大城府** (Ayutthaya)、**曼谷** (Bangkok) 及 **巴吞他尼府** (Pathum Thani) 以及東部之**北柳府** (Chacheongsao)、**春武里府** (Chonburi)。

# 泰國電子與半導體產業政策與獎勵 (2025-2026)

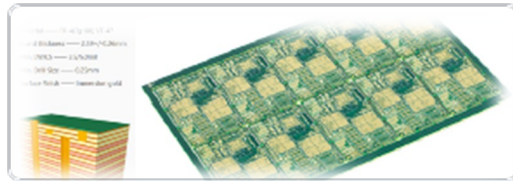
## 1 高規晶片設計與科技

- ✓ **核心技術**：電子設計自動化 (EDA)、嵌入式系統、生成式 AI 及量子計算。
- ✓ **所得稅優惠**：享有**8至13年**企業所得稅豁免。
- ✓ **額度無上限**：研發項目之免稅額度**無上限限制**。
- ✓ **核心要求**：須落實產學研發合作與實質技術轉移。



## 2 先進電子與高階 PCB

- ✓ **核心項目**：HDI、IC載板、高階車載電池及被動元件
- ✓ **基本優惠**：享有**5至8年**企業所得稅免稅額。
- ✓ **EEC 園區加碼**：進駐 EEC指定園區，免稅最高延展至**11年**。
- ✓ **產業聚落**：高階PCB板廠於春武里與羅勇形成群聚



## 3 泰國製造與智慧升級

- ✓ **在地零件採購加碼**：採用泰國製造認證零組件達標，額外加碼**1-3年免稅**
- ✓ **自動化製程升級**：導入自動化產線享**3年免稅** (最高折抵設備投資額 50%)
- ✓ **採購在地升級**：自動化設備 30% 以上購自泰國製造，額度拉高至 **100%**。



## 泰國政府推動重點



### 供應鏈在地深化

強迫外資大廠將零組件採購在地化，帶動特化材料、檢測設備迎來採購紅利。



### 緩解最低稅負制衝擊

首創 **QRTC** (可退還稅額抵免) 制度，研發與高端人才訓練支出直接「退現」。



### 物流與水患風控

EEC 園區海空運配套完整，綠電與再生水齊備，可免除傳統北部圈歷史水患風險

## 推動落地 關鍵要素

### 人才培育實質審查

企業須承諾培訓達總勞動力**10倍**人數之泰籍工程師與畢業生

### 基礎電網容量確認

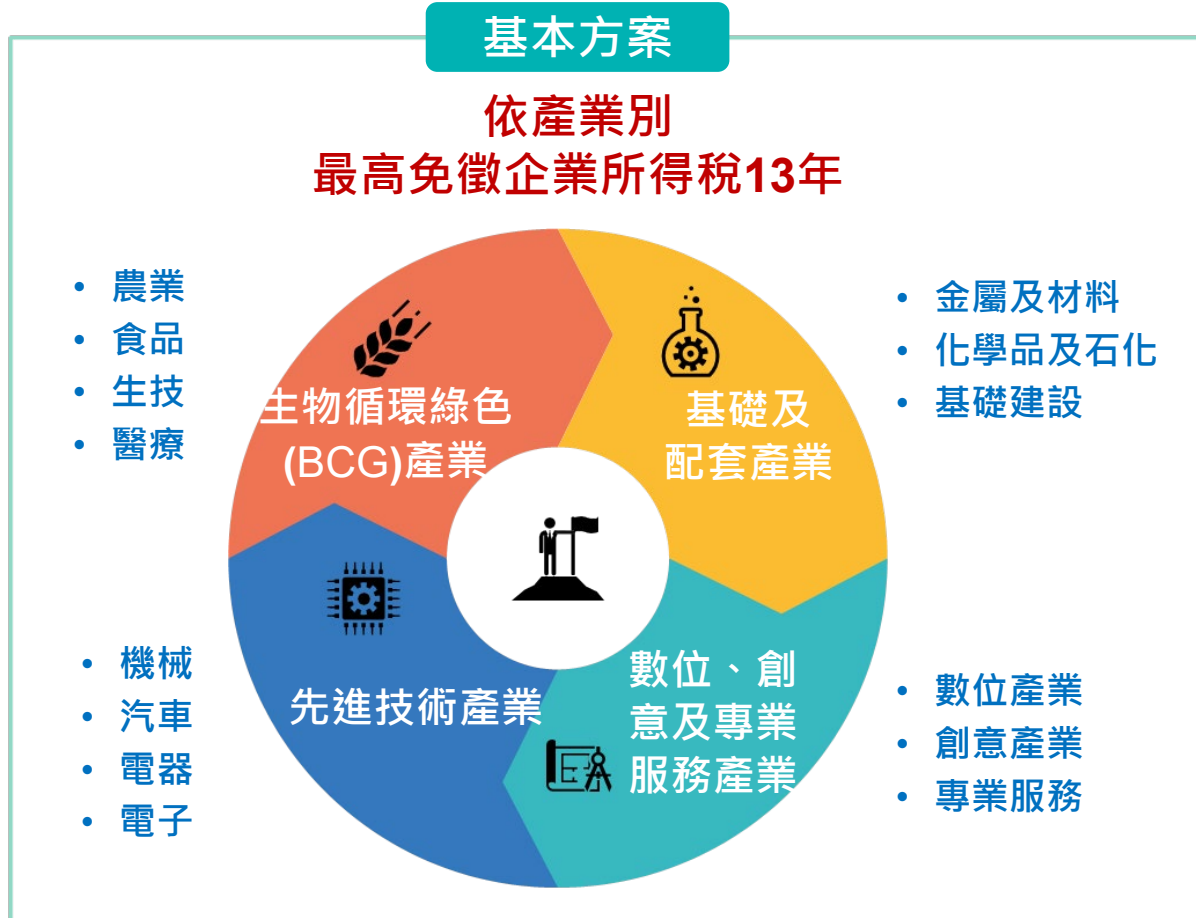
大宗電力 (如封測廠) 遞件前，須先取得泰國能源監管會供電確認函

### FastPass 綠色通道

投資額超**10億泰銖**享一站式加速審批，但需承諾**6個月**內落實**20%**資金。

# 泰國投資優惠框架

- 根據泰國投資促進委員會(BOI)的投資手冊內容，泰國投資優惠分為A1+(如晶圓製造)、A1(如電子設計、儲能製造)、A2(IC製造或封測、PCB及其零組件製造)、A3(如電器產品、設備及其零組件製造)、A4、B共6個級別，係由基本方案再疊加額外獎勵，以此計算企業的投資項目可取得的企業所得稅免徵年限。
- 基本方案主要以產業別判定，而額外獎勵以提升競爭力、特定區域或是其他特殊獎勵措施進行衡量。

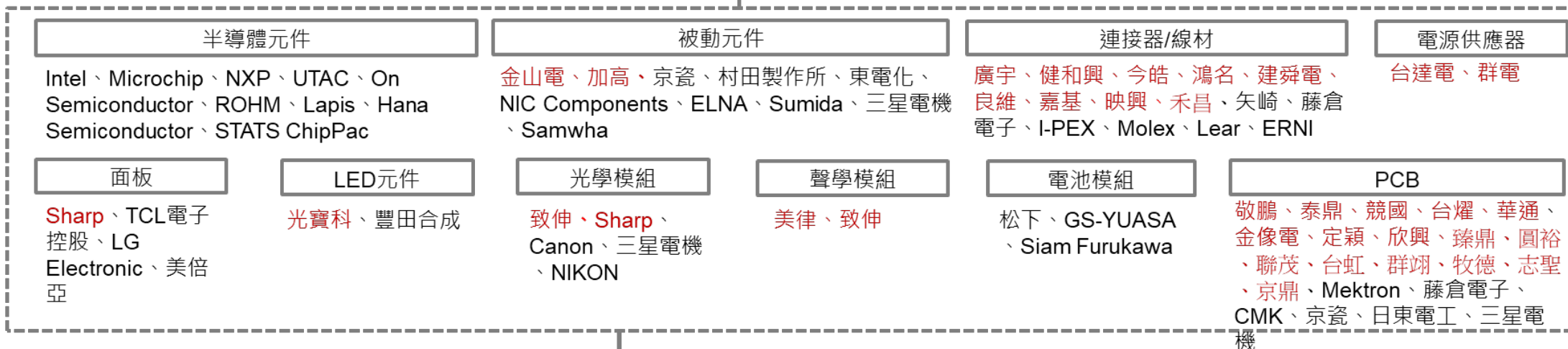


# 泰國電子產業結構

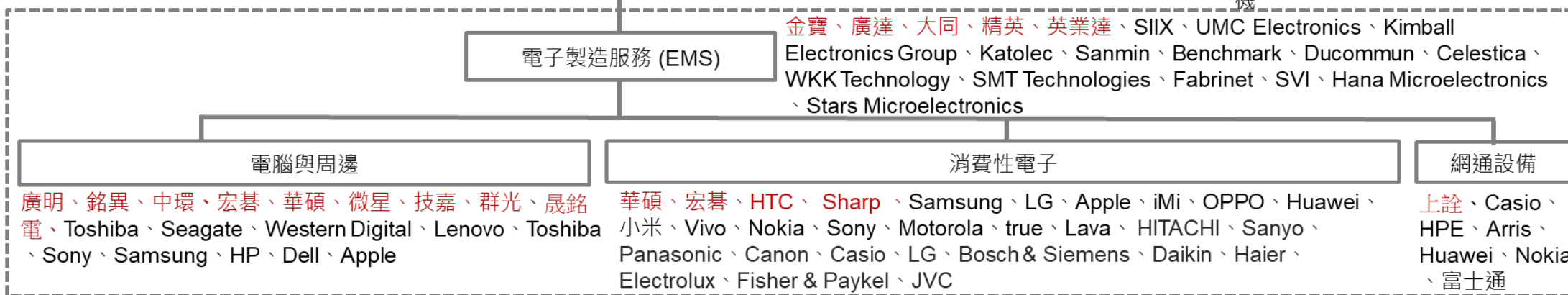
支援產業  
上游與



中游零組件與系統模組

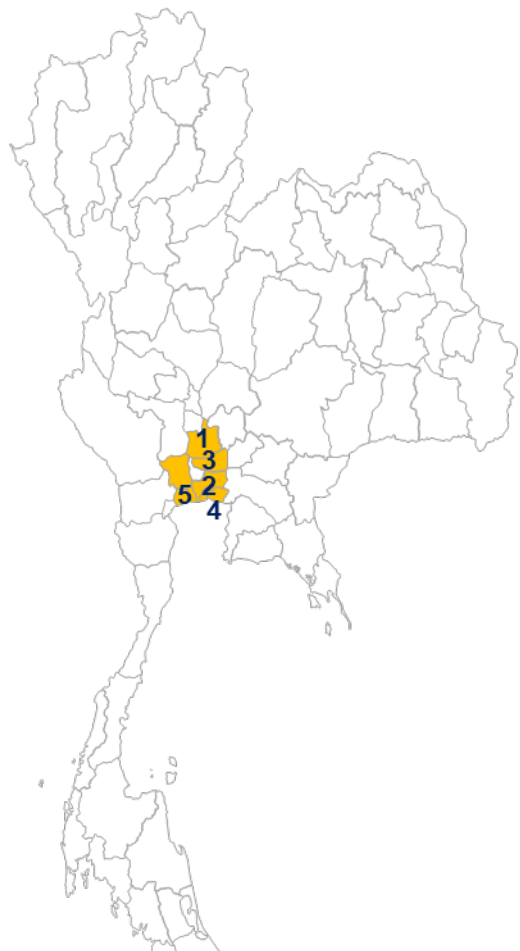


終端產品  
下游組裝與



註：紅字為臺灣廠商；本表僅列出於泰國設立營運據點(含維修)、研發中心及工廠之代表性廠商

# 泰國主要電子製造產業聚落 (1/2)



聚落高度集中、彼此車程可及，形成綿密的中部電子製造帶，臺商在多個府都有要角

## 1. 大城府 Ayutthaya

- 電子製造服務 (EMS)：SIIX(日)、Katolec(日)、Benchmark(美)、Hana Microelectronics(泰)、新金寶(臺)
- 電子零組件：Nippon Mektron(日)、日東電工(日)、藤倉電子(日)、Canon(日)、東電化(日)、NIKON(日)、Seagate(美)、Western Digital(美)、Elec & Eltek(港)、KCE Technology (泰)、廣明(臺)、美蓓亞(日)、銘異(臺)、聯德(臺)、競國(臺)、Hana Microelectronics(泰)

## 2. 曼谷 Bangkok

- 品牌廠：Samsung(韓)
- 電子製造服務 (EMS)：WKK Technology(港)、
- 電子零組件：光寶科(臺)、金山電(臺)、TCL電子控股(中)、矢崎(日)、LG Electronic(韓)、富士通(日)、富士電機(日)、欣興(臺)、群翊(臺)

## 3. 巴吞他尼府 Pathum Thani

- 電子製造服務 (EMS)：Sanmina(美)、SVI(泰)、Fabrinet (英屬開曼)、Elec & Eltek(港)、英業達(臺)
- 電子零組件：光寶科(臺)、藤倉電子(日)、ROHM(日)、NIC Components(日)、Sumida(日)、敬鵬(臺)、志超(臺)、富士電機(日)、牧德(臺)

## 4. 沙沒巴干府(北欖府) Samut Prakan

- 電子製造服務 (EMS)：SIIX(日)、華通(臺)
- 電子零組件：台達電(臺)、健和興(臺)、GS-YUASA(日)、松下(日)、矢崎(日)、映泰(臺)、建舜電(臺)、雙鴻(臺)、光群雷(臺)、正美(臺)、泰碩(臺)、映星(臺)、信音(臺)、詮欣(臺)、正凌(臺)、住友(日)、富士電機(日)、志聖(臺)

## 5. 龍仔厝府(沙沒沙空府) Samut Sakhon

- 電子製造服務 (EMS)：新金寶(臺)
- 電子零組件：豐田合成(日)、泰鼎(臺)

資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「2025 東協五國及印度電子產業地圖」之研究成果

# 泰國主要電子製造產業聚落 (2/2)



臺商聚落高度集中春武里府及北柳

產業科技國際策略發展所

註：僅列代表廠商

## 1. 北柳府(差春騷府) Chachoengsao

- 電子製造服務 (EMS)：UMC Electronics(日)
- 電子零組件：Sharp(臺)、群光(臺)、群電(臺)、良維(臺)、旭品(臺)、台達電(臺)、厚聲(臺)、GS-YUASA(日)、矢崎(日)、三星電機(韓)、兆利(臺)、Samwha(韓)、Molex(美)、住友(日)
- 半導體元件：Microchip Technology(美)
- 電腦與周邊：群光(臺)、晟銘電(臺)

## 2. 春武里府 Chonburi

- 品牌廠：Samsung(韓)
- 電子製造服務 (EMS)：Kimball Electronics Group(美)、Celestica(加)、廣達(臺)、大同(臺)、Katolec(日)
- 電子零組件：台虹(臺)、豐田合成(日)、日東電工(日)、富士通(日)、I-PEX(日)、HGST(美)、今皓(臺)、鴻名(臺)、精英(臺)、萬泰科(臺)、萬旭(臺)、群電(臺)、致伸(臺)、Samtec(美)、Samwha(韓)、住友(日)、京鼎(臺)、禾昌(臺)
- 半導體元件：Analog Devices(美)

## 3. 羅勇府 Rayong

- 電子零組件：美律(臺)、致伸(臺)、LG(韓)、住友(日)、健和興(臺)、聯穎(臺)、京鼎(臺)
- 网通設備：上詮(臺)

資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「2025 東協五國及印度電子產業地圖」之研究成果

# 簡報大綱

1. 泰國電子投資環境及產業地圖解析
- 2. 馬來西亞投資環境及產業地圖解析**
3. 印尼投資環境及產業地圖解析
4. IEKView

# 馬來西亞產業發展概述

- 
1. 檳城 (Penang)
  2. 雪蘭莪 (Selangor)  
吉隆坡 (Kuala Lumpur)
  3. 柔佛 (Johor)

## 總體經濟

- 2025年實質GDP成長率為4.9%，較去年略有放緩。雖全球地緣政治情勢及美國關稅政策帶來壓力，使成長動能減弱，但在AI、資料中心與半導體等需求擴張的帶動下，出口表現依然穩健。
- 馬來西亞為東南亞第四大經濟體，2025年人均GDP約**13,950美元**，為**中高收入國家**，**出口及民間消費**為最GDP主要成長動能，次要為投資。
- 投資環境持續**吸引大型資料中心**相關投資，成為支撐經濟的重要力量。EIU預測，馬來西亞2026-2030年的經濟成長率將維持在4.5-5.0%左右。

## 產業成長動能

- 馬來西亞近期外資主要投資產業為**半導體封測**及**伺服器**產業供應鏈。在半導體封測方面，除了日月光外，長華與界霖等導線架廠商也在當地設廠；伺服器領域則有緯穎負責組裝，勤誠與聯德控股等業者也積極布局相關零組件生產。

## 主要電子產業聚落

- 馬來西亞主要電子產業聚落位於馬來半島西部沿海區域，包含**檳城州**(Penang)、**雪蘭莪州**(Selangor)、**柔佛州**(Johor) 三州及首都**吉隆坡**(Kuala Lumpur)。

資料來源：國際貨幣基金 (IMF)；馬來西亞投資發展局(MIDA)；國際貿易中心(ITC)；工研院產科國際所

# 馬來西亞產業推動政策總覽



馬來西亞推動《第十三大馬計畫》(2026-2030)、國家半導體戰略 (NSS)、2030年新工業大藍圖 (NIMP 2030)，聚焦高價值產業，包含半導體、電動車、人工智慧、淨零排放等，並提供多元獎勵措施，促進國家半導體、工業轉型、綠色科技等領域發展。

## 產業政策

第十三大馬計畫  
(RMK13)

馬來西亞總理安華於2025年7月31日向國會提呈《第十三大馬計畫RMK13》，計畫執行期間為2026年至2030年，主題為「重塑發展」，除了注重GDP的發展，也強調以人為本、社會正義與永續治理，進而公平、公正地造福人民。

國家半導體戰略  
(NSS)

2025年2月18日馬來西亞國家投資理事會會議，批准實施「國家半導體戰略」，期望發展10家與半導體相關的本地企業，並同時支持成立100家其他高附加價值業務的公司，每家的年營收預計約10億馬幣(約2.25億美元)公司。

2030年新工業大藍圖  
(NIMP2030)

2023年9月馬來西亞政府推出「2030年新工業大藍圖」，聚焦四大使命，並列出21種策略性產業，涵蓋半導體、化工材料、智慧製造、人工智慧、電動車、淨零排放、航空航太等領域，以9大產業戰略計畫為執行方案。

## 配套措施

柔佛—新加坡經濟特區  
(JS-SEZ)

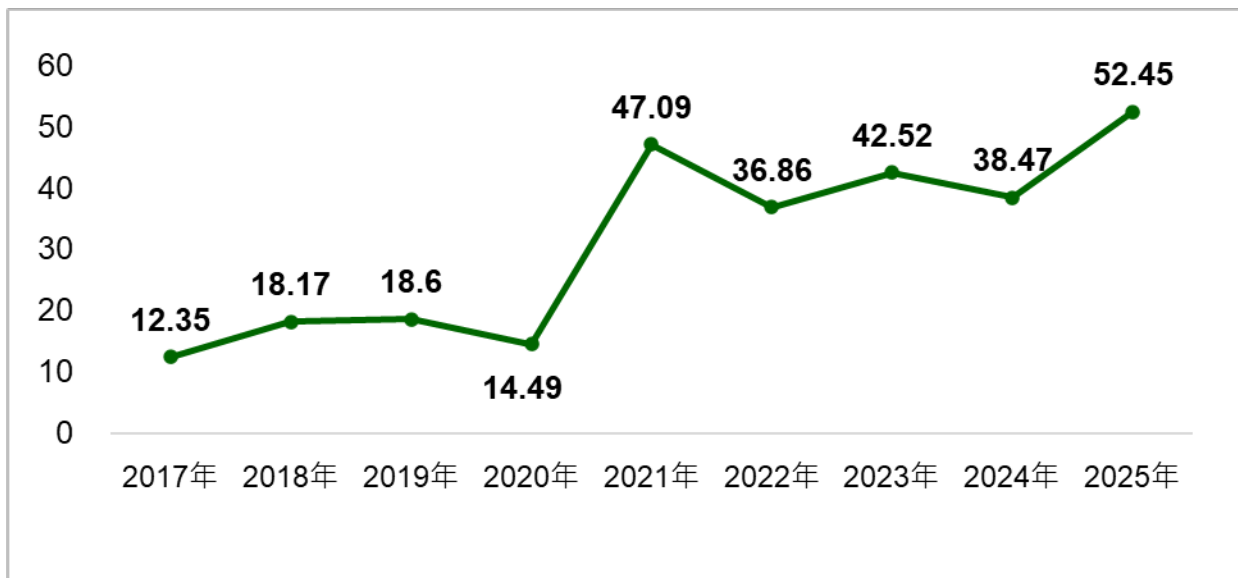
2025年1月6日馬來西亞和新加坡共同簽署「柔佛—新加坡經濟特區」協議，JS-SEZ位於馬國柔佛州南部(9區域)，占地3,571平方公里。目標首5年推動50個計畫、10年內擴展100個投資項目，並創造2萬個高技能就業機會

# 馬來西亞FDI持續增長，主要來自電子電機產業

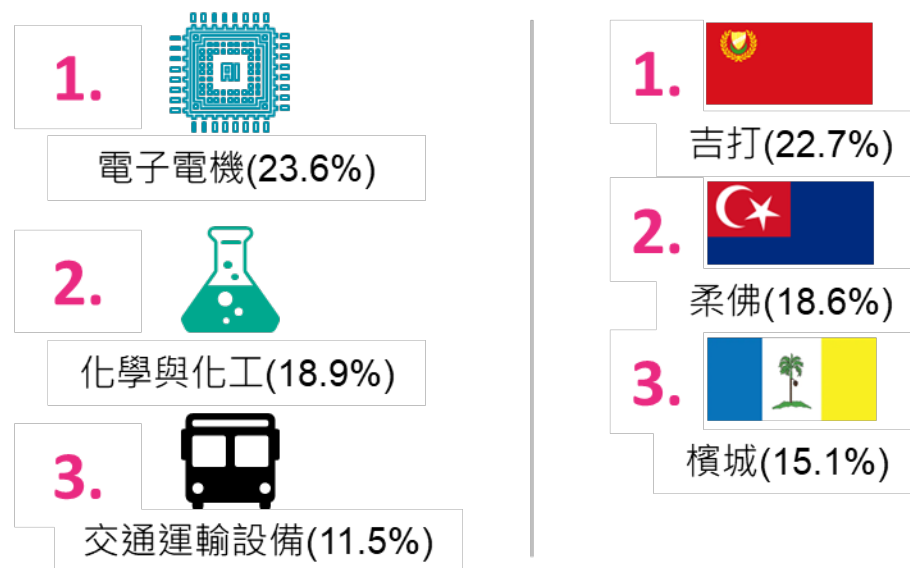
- 根據馬來西亞投資發展局(MIDA)統計，2025年馬來西亞的FDI約為**524.50億美元**，較去年同期成長**32.8%**。
- 從投資產業結構來看，2025年外資主要流向服務業(占50.2%)，其次為製造業(占48.6%)。
- 在製造業內，最受外資青睞的產業為**電子電機產業**(占製造業投資額的23.6%)，其次為**化學與化工產業**(18.9%)以及**交通運輸設備**(11.5%)。外資在2025年製造業的區域布局則主要集中於**吉打**(22.7%)、**柔佛**(18.6%)與**檳城**(15.1%)三地。

## 2017-2025年馬來西亞外國直接投資

單位：十億美元



## 2025年外資主要投資製造業概況



# 馬來西亞投資優惠框架

- 馬來西亞**製造業**主要投資優惠有兩大核心：新興工業地位(Pioneer Status)、投資賦稅減免(Investment Tax Allowance)，依據投資生產之產品及投資金額，享有不同所得稅率減免及不同年限之投資優惠，其中**新興工業地位及投資賦稅減免二擇一使用**。另亦有其他加值優惠或非製造業優惠。

## 新興工業地位 (Pioneer Status)

新興工業地位提供獲得MIDA核准的企業授予**生產特定推廣產品**之企業，其享有**全免稅期**或**部分減稅期**，減免期將從公司達到產能30%的那一天起算。

OR

## 投資抵稅優惠 (ITA)

獲得MIDA核准後，針對100%或60%**合格資本支出(如工廠、廠房、機械或其它設備)**，可享有**5年或10年的投資抵稅期**。



## 免徵進口稅

- 從事製造業活動之公司有機會享有原料、零部件(直接用於生產最終成品)的進口稅與銷售稅減免。(原料或零部件之**進口或購買前**向MIDA申請)

## 區域發展

- 區域發展獎勵：設在東馬(沙巴、砂拉越)或**特定發展區域**，提供更優惠的獎勵。

## 研發支出獎勵

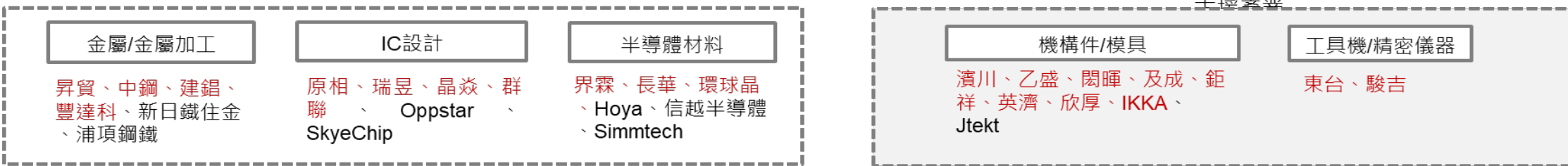
- 無論是否享受PS或ITA，公司都可以針對其**研發支出**申請額外的稅務優惠

## 其他類優惠

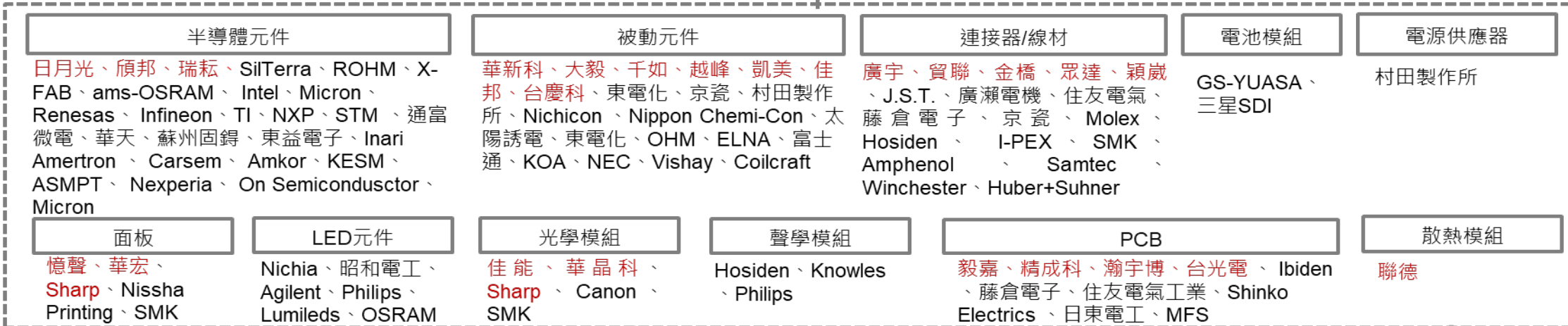
- 非製造業稅負優惠**：全球服務中心(Global Service Hub)：企業從事區域業務管理、戰略及發展規劃，並同時從事戰略服務、商業服務、共享外包服務及其他服務等四項服務中的任兩種業務
- 再投資津貼(Reinvestment Allowance, RA)**：目前從事製造業的現有公司，為了擴充產能、進行自動化、現代化或產品多樣化，而再增加投資，且已投入生產至少36個月。
- 物流和倉儲獎勵**：鼓勵發展高科技、自動化物流和倉儲中心的稅務優惠。

# 馬來西亞電子產業結構

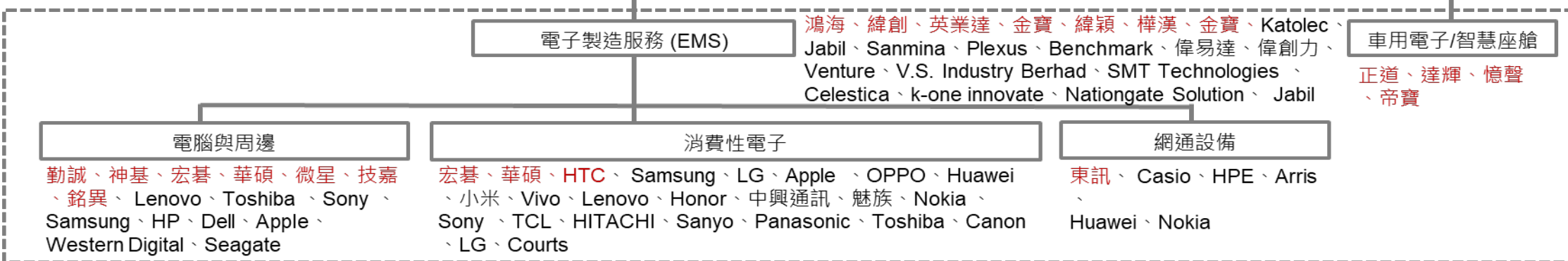
支援產業  
上游與



中游零組件與系統模組



終端產品  
下游組裝與



註：紅字為臺灣廠商；本表僅列出於馬來西亞設立營運據點(含維修)、研發中心及工廠之代表性廠商

資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「2025 東協五國及印度電子產業地圖」之研究成果

# 馬來西亞主要電子製造產業聚落

## 1. 檳城 Penang(半導體封測重鎮)

品牌廠	Lenovo(中)、Dell(美)
電子製造服務 (EMS)	英業達(臺)、Katolec(日)、和泰電子(臺)、Benchmark(美)、JABIL(美)、Plexus(美)、Sanmina(美)、偉創力(新)、京瓷(日)
PCB	Ibiden(日)、毅嘉(臺)、藤倉電子(日)、日東電工(日)、精成科(臺)、Simmtech(韓)、Sanmina(美)、瀚宇(臺)
被動元件	大毅(臺)、京瓷(日)、ELNA(日)、佳邦(臺)、華新(臺)
連接器	京瓷(日)、藤倉電子(日)、廣宇(臺)、宣德(臺)、Amphenol(美)、Samtec(美)、Molex(美)、Winchester(美)、貿聯(臺)、穎威(臺)
電源供應器	光寶科(臺)、力信興業(臺)、Advanced(美)
聲學模組	Knowles(美)、Philips(荷)
光學模組	CANON(日)
面板	閱暉(臺)、及成(臺)
LED元件	憶聲(臺)、華宏(臺)
半導體元件	瑞薩電子(日)、Intel(美)、日月光(臺)、Aemulus(馬)、Globetronics(馬)、Microchip(美)、Micron(美)、晶焱(臺)、世芯(臺)、碩邦(臺)



## 2. 雪蘭莪 Selangor /吉隆坡 Kuala Lumpur (EMS、連接器、半導體)

電子製造服務 (EMS)	緯創(臺)、新金寶(臺)、k-one innovate (馬)、偉創力(新)
PCB	住友電氣工業(日)、Shinko Electric(日)
被動元件	Nichicon(日)、Nippon Chemi-Con(日)、千如(臺)、NEC Corporation(日)、Sumida(日)
連接器	廣瀨電機(日)、Hosiden(日)、SMK(日)、Huber+Suhner(瑞士)、藤倉(日)、住友(日)、中探針(臺)
面板	Sharp(臺)、Nissha(日)、SMK(日)、日本電氣(日)
聲學模組	Hosiden(日)
光學模組	Sharp(臺)、Canon(日)、SMK(日)
LED元件	Nichia(日)、昭和電工(日)
機構件	乙盛(臺)
IC設計	瑞昱(臺)
半導體元件	Amkor(美)、TI(美)、NXP(荷)、Globetronics(馬)、瑞薩電子(日)

## NVIDIA / YTL AI 聚落

## 3. 柔佛 Johor(EMS、AI伺服器、儲存)

品牌廠	HP(美)
電子製造服務 (EMS)	偉易達(港)、Celestica(加)、偉創力(新)、Venture(新)、V.S. Industry Berhad(馬)、鴻海(臺)、新金寶(臺)、緯穎(臺)、貿聯(臺)
PCB	住友電氣工業(日)
被動元件	東電化(日)、富士通(日)、Coilcraft(美)、奇力新(臺)、東電化(日)、臺慶科(臺)
連接器	住友電氣(日)、I-PEX(日)、貿聯(臺)、Amphenol(美)、Samtec(美)、J.S.T.(日)
電源供應器	東電化(日)
面板	Sharp(臺)
光學模組	Sharp(臺)
LED元件	昭和電工(日)
電腦與周邊	Micron(美)、銘異(臺)、Western Digital(美)
機構件	乙盛(臺)
半導體元件	STM(瑞)、Micron(美)

# 簡報大綱

1. 泰國電子投資環境及產業地圖解析
2. 馬來西亞投資環境及產業地圖解析
- 3. 印尼投資環境及產業地圖解析**
4. IEKView

# 印尼產業發展概述



## 總體經濟

- 印尼為**東協最大經濟體**，根據EIU數據，**2025年印尼GDP達1.45兆美元**，實質GDP成長率為5.11%。EIU預估2026年印尼GDP將達到1.5兆美元，展望2030年，印尼GDP預估將突破1.98兆美元。
- 製造業是對印尼GDP貢獻度最高的產業，**2025年製造業對印尼GDP貢獻比例達19.07%**，其次為零售/汽機車維修業(13.17%)、農林漁牧業(13.10%)。

## 產業成長動能

- 印尼積極推動電子產業發展，致力於降低電子零組件進口比例。期望透過「印尼4.0」建立具規模的電子產品生產能力，吸引國際大廠投資，提升手機、面板及行動裝置等領域的生產技術。同時，印尼近期也加速導入自動化與智慧製造，帶動整體電子產業升級，強化其全球競爭力。

## 主要電子產業聚落

- 印尼主要電子產業聚落位於區域中心爪哇島之西側，包含**西爪哇省(West Java)**、首都特區**雅加達(Jakarta)**及位於廖內群島省之電子製造中心**巴淡島(Batam)**。

# 近年印尼重點產業政策

## 產業基礎建構

### 基礎建設



- **印尼2020-2024年國家中期發展計畫 (RPJMN)**：持續發展基礎建設，包括國家首都計畫、爪哇島高鐵、港口、水庫、公路、工業區、冶煉廠等。
- **遷都計畫**：2022年通過法案，將首都從雅加達遷至東加里曼丹省，並命名為**Nusantara**，計劃打造為未來智慧城市與工業4.0中心。
- **印尼2025-2029年國家中期發展計畫 (RPJMN)**：持續進行陸、海、空基礎建設與新首都發展。

### 強化製造 / 工業4.0



- **印尼工業4.0**：為**強化印尼製造業能力**，政府於2018年公布「印尼工業4.0」(Making Indonesia 4.0) 藍圖，聚焦發展食品飲料、紡織成衣、汽車、電子、化學製藥等產業。
- **關鍵技術投入**：配合升級轉型，持續發展物聯網、人工智慧、人機介面、3D列印、機器人與感測技術等科技。

## 策略產業推動

### 數位經濟/人工智慧



- **2030年數位經濟發展國家策略白皮書**：提升網路普及率並持續投入**數位基礎建設**、透過稅務優惠促進研發創新、支持企業**數位轉型**與**數位金融**發展、同時強化數位人才培育，加速數位轉型進程。
- **國家人工智慧藍圖白皮書**：
  1. 發展**AI生態系**，投入人才培育與數位基礎建設
  2. 確立AI發展優先領域：醫療、教育、能源與運輸等
  3. 規劃AI融資機制，提供相應投資優惠與補貼

### 電動車



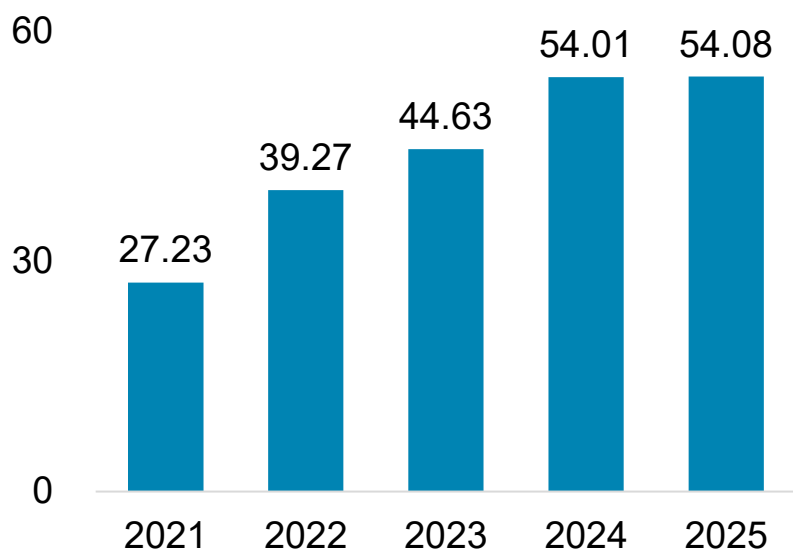
- **2019年第55號總統條例**：涵蓋**純電動車自製率**要求(2023年修正：**本地自製率須在2026年達40%**)、充電基礎設施營運條件、電動車註冊規範等，為產業發展提供政策框架。
- **2022年第6號工業部部長條例**：規劃於**2030年生產60萬輛**四輪及以上之電動車。
- **出口禁令**：2020年1月起**禁止鎳礦直接出口**，以推動廠商進入印尼投資冶煉與加工產業，提升礦產資源附加價值。

# 新加坡為印尼最大的外資來源國



- **FDI金額小幅成長**：根據印尼投資暨下游化部 (Ministry of Investment and Downstreaming/ BKPM)統計，2025年印尼FDI金額約**540億美元**，與2024年相比小幅成長0.14%。外資主要投資產業為**金屬製造**(占26%)、**採礦**(占8.42%)、運輸、倉儲及通訊業(占5.82%)
- **新加坡為最大投資國**：2025年前五大外資來源國或地區依序為新加坡、香港、中國、馬來西亞、日本。以投資地點來看，經濟重心的**爪哇島**仍是多數外商的首選之地，爪哇島5大主要行政區合計投資金額占整體外資投資金額比例達44%。

## 2021年-2025年印尼外資投資概況






單位:十億美元



## 2025年外資主要投資產業

產業	占比
 金屬製造業	26.00%
 採礦業	8.42%
 運輸、倉儲及通訊業	5.82%

## 2025年前五大外資來源

外資來源	占比
 新加坡	30.90%
 香港	18.89%
 中國	13.32%
 馬來西亞	7.92%
 日本	5.56%

# 印尼投資優惠框架

- 印尼投資優惠主要有免稅期(Tax Holiday)、租稅抵減(Tax Allowance)、投資抵減(Investment Allowance) 與超級減稅方案(Super Tax Deduction)共4類，其中**免稅期**及**租稅抵減**優惠方案僅能**擇一適用**。另亦有設備原物料免進口關稅2年(Import Duty Exemption)之優惠。
- 若在經濟特區(Special Economic Zone, SEZ)設廠，可享有更多的投資優惠內容。

## 免稅期(Tax Holiday)

- 依據投資金額不同，免稅期間內**最高可享****有20年完全免繳企業所得稅**。免稅期結束後2年最高可享受企業所得稅減半優惠。
- 需屬於先鋒產業且為新投資計畫，最低投資金額為1,000億印尼盾(約600萬美元)。

## 租稅抵減(Tax Allowance)

- 公司固定資產(含土地)**投資總額的30%**，可分配在6年內抵減公司之應課稅收入。
- 投資所直接使用之固定資產可享有加速折舊；無形資產享有加速攤銷。

## 設備原物料免進口關稅2年(Import Duty Exemption)

- **新設廠或擴廠**：此項優惠主要針對在印尼進行新投資或擴大產能的製造業公司。
- **投資計畫**：公司需要向印尼政府提交一份完整的投資計畫書，詳細說明工廠的建設、生產流程、所需進口設備與原物料清單，並獲得批准。
- **申請核准後**，進口設備須在2年的期限內進口完畢。若2年期滿且公司尚未投產，視投資金額可申請展延，最高展延5年。

## 投資抵減(Investment Allowance)

- 適用於**勞力密集型產業**之投資，公司固定資產(包含土地)**投資總額的60%**，可分配在6年內抵減公司之應課稅收入。

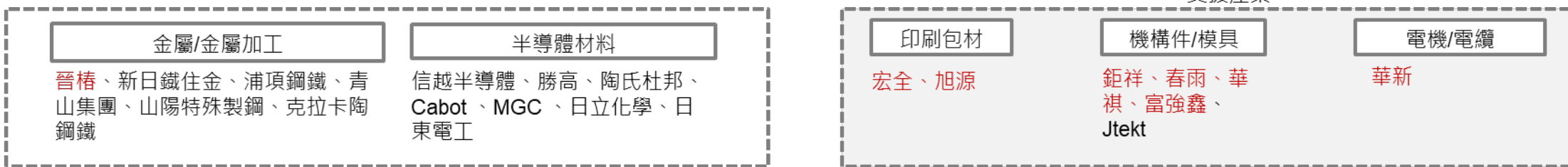
## 超級減稅方案(Super Tax Deduction)

- **職業培訓**活動費用抵減企業所得稅，最高限額為活動費用的2倍。
- **研發活動**支出抵減企業所得稅，最高限額為研發活動支出的3倍。

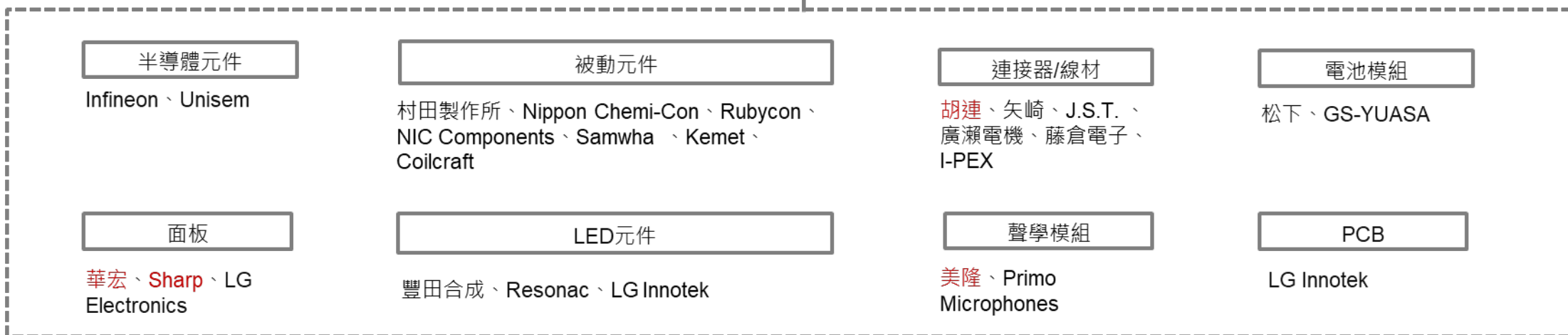
# 印尼電子產業結構

支援產業  
上游與

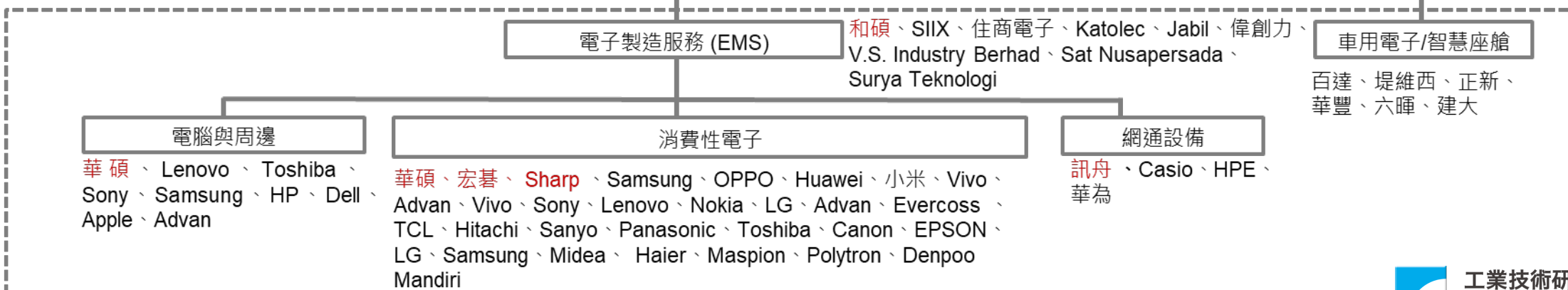
支援產業



中游零組件與系統模組



終端產品  
下游組裝與



# 印尼主要電子製造產業聚落

以品牌與整機組裝、零組件供應為主，貼近龐大內需市場；半導體與PCB相對輕量



## 巴淡島 Batam(出口EMS、被動、半導體)

品牌廠	小米(中)
電子製造服務(EMS)	和碩(臺)、SIIX(日)、Sat Nusapersada(印尼)、Surya Teknologi(印尼)、偉創力(新)
被動元件	Rubycon(日)、Kemet(美)、Coilcraft(美)
聲學元件	Primo Microphones(新)
半導體元件	Infineon(德)、Unisem(馬)

## 雅加達 Jakarta(EMS、零組件、周邊)

電子製造服務(EMS)	SIIX(日)
連接器	藤倉電子(日)、J.S.T.(日)
電池模組	GS-YUASA(日)
面板	Sharp(臺)
LED元件	RESONAC(日)
電腦及周邊	華碩(臺)

## 1. 萬丹省Banten(連接器、電池)

連接器	矢崎(日)
電池模組	GS-YUASA(日)

## 4. 東爪哇省East Java(連接器)

連接器	矢崎(日)
-----	-------

## 3. 中爪哇省Central Java(在地品牌、連接器)

品牌廠	Polytron(印尼)、Evercoss(印尼)
連接器	矢崎(日)
電腦與周邊	Avan(印尼)

## 2. 西爪哇省 West Java(品牌、EMS、零組件大本營)

品牌廠	Samsung(韓)、Toshiba(日)、OPPO(中)、Vivo(中)	電池模組	松下(日)、加百裕(臺)
電子製造服務(EMS)	住商電子(日)、華冠(臺)、Katolec(日)、Jabil(美)、V.S. Industry Berhad(馬)、Haier(中)	面板	Sharp(臺)、LG Electronic(韓)、華宏(臺)
半導體材料	日東電工(日)	光學模組	Sharp(臺)、LG Innotek(韓)
PCB	LG Innotek(韓)	LED元件	豐田合成(日)、LG Innotek(韓)、冠西電(臺)
被動元件	大毅(臺)、Nippon Chemi-Con(日)、村田製作所(日)、Samwha(韓)	聲學元件	美隆(臺)
連接器	廣瀨電機(日)、胡連(臺)	電腦及周邊	宏碁(臺)

# 簡報大綱

1. 泰國電子投資環境及產業地圖解析
2. 馬來西亞投資環境及產業地圖解析
3. 印尼投資環境及產業地圖解析

## 4. IEKView

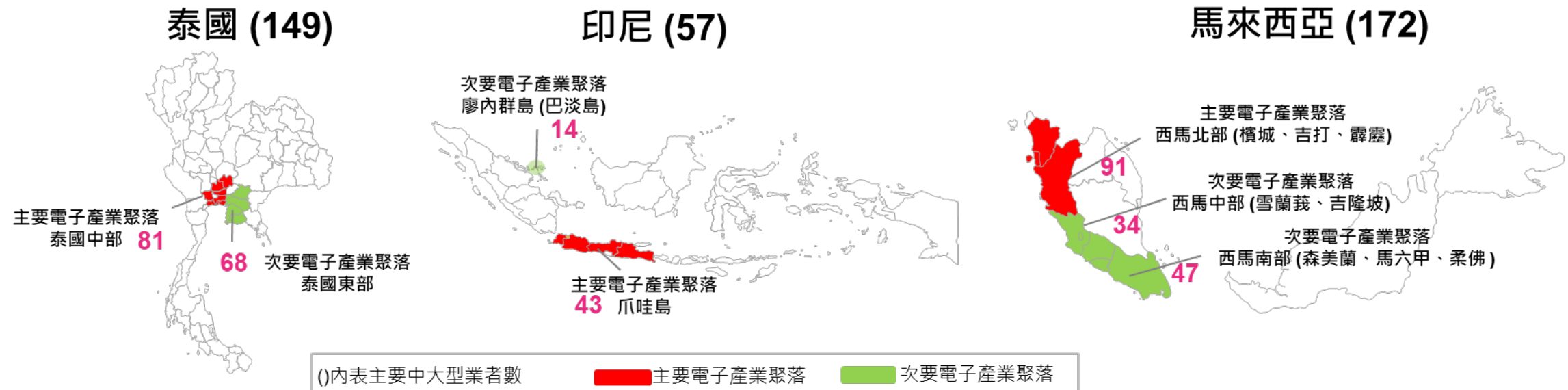
# 泰、馬、印尼三國產業定位

印尼憑藉內需市場展現優勢；馬來西亞受惠於先進封裝設備及AI資料中心密集啟用居中；泰國在克服綠電瓶頸與車電組裝轉型的陣痛中，力求穩定復甦。

國家	產業定位	核心驅動優勢	臺商戰略布局建議
印尼 (Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"><li>資源下游化 ( 鎳→EV 電池 )</li><li>資料中心起步</li><li>強韌大內需市場</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>鎳礦全產業鏈閉環</li><li>人口與新首都內需紅利</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>切入資源深加工</li><li>儲能電池及龐大消費內需市場。</li></ul>
馬來西亞 (Malaysia)	<ul style="list-style-type: none"><li>OSAT、先進封裝、設備材料</li><li>受惠半導體上行週期</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CoWoS先進封裝升級</li><li>亞太AI算力外溢效應</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>布局先進封測</li><li>AI 算力資料中心機電與伺服器配套。</li></ul>
泰國 (Thailand)	<ul style="list-style-type: none"><li>資料中心、HDD、智慧電子、EV</li><li>EEC 製造核心</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>EV 3.5 補貼</li><li>PCB完工量產聚落</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>建立高值化電子與車電產線</li><li>爭取優渥綠電配額</li></ul>

# 因應聚落特性進行「製程—選址」精準匹配聚落

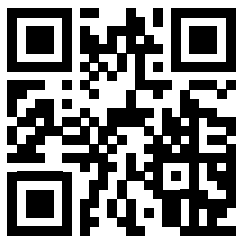
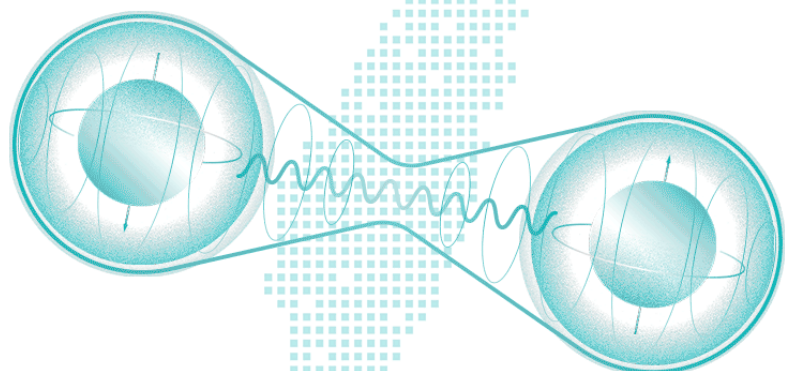
- **規模與聚落效應**：馬、泰以電子業雙核心，印尼走民生消費路線。
- 馬國由西馬北部扮演高端封測與晶片大腦，西馬中部提供樞紐支持，再一路向南部延伸至西馬南部（柔佛等）對接新加坡，形成了極具韌性的**縱深產業帶**。
- **高規與封測導向（往馬來西亞北部/南部）**：若台商未來投資屬於高毛利、需要密集半導體人才與國際物流對接的製程（如先進封測、IC載板、高階交換器），馬國北部與南部仍是首選，能直接融入當地現有生態圈。
- **重硬體與伺服器組裝（往泰國中部/東部）**：若涉及大量機殼、被動元件、散熱金屬件及大型組裝，應鎖定泰國中部或東部 EEC 聚落，以發揮最龐大的在地化採購與供應鏈協同效應。



資料來源：工研院產科國際所承接經濟部投資促進司「2025 東協五國及印度電子產業地圖」之研究成果

# 無限量

量子百年  創新紀元



IEK產業情報網



2025專刊

吳佩玲 副組長/博士

亞太產業研究組

02-2737-7874

Sharon.wu@itri.org.tw

亞太產業研究團隊

葉建宏、林思羽、紀佳妤、林家毅

以上簡報所提供之資訊，在尖端科技發展與產業變動中，無法保證資訊的時效性及完整性，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有，非經書面允許，不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。